



2008 年度第一次临时股东大会会议资料

2008 年 10 月 13 日

会 议 议 程

- 1、 审议关于公司前次募集资金使用情况的议案
- 2、 审议关于公司 2008 年度配股符合配股资格的议案
- 3、 逐项审议关于公司 2008 年度配股方案的议案
 - 1) 本次配售股票类型及面值
 - 2) 本次配股基数、比例和数量
 - 3) 本次配股定价方法及配股价格
 - 4) 本次配股配售对象
 - 5) 本次配股募集资金的用途
 - 6) 本次配股承销方式
 - 7) 本次配股决议的有效期限
- 4、 审议关于公司 2008 年度配股募集资金使用可行性报告的议案
- 5、 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案
- 6、 审议关于修改公司章程部分条款的议案

一、 审议关于公司前次募集资金使用情况的议案

各位股东：

2007年1月公司以2005年12月31日总股本970,447,028股为基数，按每10股配3股比例配售股票，配股总数为270,816,197股，每股配股价为人民币2.66元，2007年1月实际配股募集资金为人民币695,592,666.98元。该笔募集资金已经使用完毕。公司董事会出具了《方正科技集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况报告》，上海上会会计师事务所有限公司出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（上会师报字(2008)第2466号），详见附件。

以上议案，提请各位股东审议。

方正科技集团股份有限公司董事会

2008年10月13日

二、审议关于公司 2008 年度配股符合配股资格的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》关于上市公司配股的相关资格、条件的要求，公司董事会对公司的实际经营情况和相关事项进行逐项检查，认为公司 2008 年度实施配股符合现行配股的有关规定，具备配股资格，同意提出 2008 年度配股申请。

以上议案，提请各位股东审议。

方正科技集团股份有限公司董事会

2008 年 10 月 13 日

三、逐项审议关于公司 2008 年度配股方案的议案

各位股东：

为实现公司可持续发展，公司提出 2008 年度配股方案，以下议案提请各位股东逐项审议，方案内容如下：

1、本次配售股票类型及面值：人民币普通股（A 股）；每股面值：人民币 1 元。

2、本次配股基数、比例和数量：

以公司截止 2007 年 12 月 31 日总股本 1,726,486,674 股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售，本次配股可配售股份总计为 517,946,002 股。

3、本次配股定价方式及配股价格：

本次配股的定价原则：

- （1）配股价格不低于公司最近一期的每股净资产值；
- （2）募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
- （3）参考公司股票在二级市场价格和市盈率情况；
- （4）与主承销商协商确定。

本次配股价格：在不低于公司最近一期每股净资产的基础上，依据本次配股确定的定价原则，采用市价折扣法确定配股价格。

4、本次配股配售对象：

待本次配股获得中国证券监督管理委员会核准后，公司将确定本次配股股权登记日，配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

5、本次配股募集资金的用途：

（1）拟增资珠海方正高密电子有限公司用于新扩建 HDI 项目，金额不超过 56,298 万元人民币；

（2）拟增资珠海方正高密电子有限公司用于新建快板项目，金额不超过 15,255 万元人民币；

（3）拟增资重庆方正高密电子有限公司用于继续建设背板项目，金额不超过 36,991 万元人民币；

(4) 拟增资方正科技集团苏州制造有限公司 20,000 万元人民币，用于补充 PC 业务流动资金。

本次配股拟募集资金不超过 128,544 万元人民币，投入上述四个项目。本次配股募集资金投资项目符合国家产业政策，具有良好的发展前景。项目投入不足部分公司自筹资金解决，本次配股资金到位前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入部分在募集资金到位之后予以偿还，本次配股资金到位后，将按项目投资计划及市场情况安排使用。

6、本次配股承销方式：

本次配股采用代销方式。

7、本次配股决议的有效期限：

自公司 2008 年度第一次临时股东大会通过本次配股议案之日起十二个月内有效。

本次配股方案须经公司 2008 年度第一次临时股东大会表决通过后，报中国证券监督管理委员会核准后实施。

以上议案，提请各位股东审议。

方正科技集团股份有限公司董事会

2008 年 10 月 13 日

四、审议关于公司 2008 年度配股募集资金

使用可行性报告的议案

各位股东：

本次公司 2008 年度配股募集资金投入具体项目如下：

1、增资珠海方正高密电子有限公司用于新扩建 HDI 项目，金额不超过 56,298 万元人民币

本公司将联合上海方正科技（香港）有限公司（以下简称“香港方正”）对珠海方正高密电子有限公司（以下简称“珠海高密”）实施增资。本公司以配股资金 56,298 万元人民币增资珠海高密，香港方正以美元同比例增资。增资完成后，本公司仍持有珠海高密 75%的股权，香港方正持有珠海高密 25%股权。

增资投入珠海高密的资金全部用于新建HDI扩产项目，达产后月产能将增加30万尺。本项目计划利用珠海富山PCB产业园预留的厂房，总投资为75,064万元，其中新增固定资产投资73,600万元，项目铺底流动资金1,464万元。

经测算，项目计算期平均净利润为16,663万元，税后内部收益率为26.51%，税后投资回收期为4.23年。

2、增资珠海方正高密电子有限公司用于新建快板项目，金额不超过 15,255 万元人民币

本公司将联合上海方正科技（香港）有限公司（以下简称“香港方正”）对珠海方正高密电子有限公司（以下简称“珠海高密”）实施增资。本公司以配股资金 15,255 万元人民币增资珠海高密，香港方正以美元同比例增资。增资完成后，本公司仍持有珠海高密 75%的股权，香港方正持有珠海高密 25%股权。

增资投入珠海高密的资金全部用于新建快板项目。

本项目计划利用珠海富山PCB产业园预留的厂房，总投资为20,340万元，其中新增固定资产投资17,000万元，项目铺底流动资金3,340万元。

经测算，项目计算期平均净利润为6,176万元，税后内部收益率为30.46%，税后投资回收期为5.76年。

3、增资重庆方正高密电子有限公司用于继续建设背板项目，金额不超过 36,991 万元人民币

本公司将联合上海方正科技（香港）有限公司（以下简称“香港方正”）对重庆方正高密电子有限公司（以下简称“重庆高密”）实施增资。本公司以配股资金 36,991 万元人民币增资重庆高密，香港方正以美元同比例增资。增资完成后，本公司仍持有重庆高密 75%的股权，香港方正持有重庆高密 25%股权。

增资投入重庆高密的资金全部用于新建背板项目。项目设计年产 270 万尺背板，项目总投资为 68,242 万元人民币，其中固定资产投资 60,383 万元，铺底流动资金 7,859 万元。

经测算，项目计算期平均净利润为 10,895 万元，税后内部收益率为 12.1%，税后投资回收期为 7.35 年。

4、增资方正科技集团苏州制造有限公司 20,000 万元人民币补充 PC 业务流动资金

目前本公司持有方正科技集团苏州制造有限公司（以下简称“方正苏州”）100% 股权，公司以配股资金 20,000 万元人民币增资方正苏州，补充公司 PC 业务的流动资金。

本次配股拟募集资金不超过 128,544 万元人民币，投入上述四个项目。本次配股募集资金投资项目符合国家产业政策，具有良好的发展前景。项目投入不足部分公司自筹资金解决，本次配股资金到位前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入部分在募集资金到位之后予以偿还，本次配股资金到位后，将按项目投资计划及市场情况安排使用。

以上议案，提请各位股东审议。

方正科技集团股份有限公司董事会

2008 年 10 月 13 日

五、审议关于提请股东大会授权董事会 全权办理本次配股相关具体事宜的议案

各位股东：

为高效、有序的完成公司本次配股工作，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关的事宜，授权范围如下：

- (1) 授权董事会全权办理本次配股申报事宜；
- (2) 在本次配股申报期间，在发行数量、募集资金总量不变的前提下，授权董事会可依据证券监管部门的审核意见，根据市场变化和公司发展的需要，对募集资金投向进行适当的调整；
- (3) 根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，授权董事会在股东大会决议范围内确定本次配股实施时间、配股价格、配售数量、发行起止日期等具体事宜；
- (4) 授权董事会签署本次募集资金投资项目运行过程中的有关重大合同和重要文件；
- (5) 授权董事会聘请有关中介机构；
- (6) 授权董事会签署与本次配股有关的各项文件及合同；
- (7) 授权董事会根据本次配股实施结果，修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记；
- (8) 配股方案有效期内，若配股政策发生变化，授权董事会按新政策继续办理本次配股事宜；
- (9) 若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东；
- (10) 相关法律法规允许的情况下，授权董事会办理其他与本次配股有关的事宜。

本授权自 2008 年度第一次临时股东大会通过本次配股议案之日起 12 个月内有效。

以上议案，提请各位股东审议。

方正科技集团股份有限公司董事会

2008年10月13日

六、审议关于修改公司章程部分条款的议案

各位股东：

根据有关规定和公司实际情况，提请股东大会修改公司章程如下：

[修改一]

第十三条 原文为：

经依法登记，公司经营范围是：

经营范围：电子计算机及配件、软件、非危险品化工产品、办公设备及消耗材料、电子仪器、建筑、装潢材料、百货、五金交电、包装材料；经营本企业研制的电子计算机及配件、软件、办公设备及配件、电子仪器及技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务。但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。税控收款机及配件的研发、生产、销售和售后服务。

经营方式：生产制造、批发、零售、代销、中介、服务、代理。”

现修改为：

经依法登记，公司经营范围是：电子计算机及配件、软件，非危险品化工产品，办公设备及消耗材料，电子仪器，建筑、装潢材料，百货，五金交电，包装材料；经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，税控收款机（涉及许可经营的凭许可证经营）。

公司经营方式是：生产制造、批发、零售、代销、中介、服务、代理。

[修改二]

第二十九条第一款原文为：

公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上有表决权的股份的股东，将其所持有的公司股票在买入之日起六个月以内卖出，或者在卖出之日起

六个月以内又买入的，由此所得收益归公司所有。本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。

现修改为：

公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上有表决权的股份的股东，将其所持有的公司股票在买入之日起六个月以内卖出，或者在卖出之日起六个月以内又买入的，由此所得收益归公司所有。本公司董事会将收回其所得收益，并及时披露相关情况。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。

[修改三]

第四十四条第一款原文为：

公司召开股东大会的地点提前通告股东。

现修改为：

公司召开股东大会的地点为公司住所地上海或者北京、深圳、重庆、苏州、珠海。

[修改四]

第一百七十三条增加如下作为第三款：

合并完成后，公司应办理股份变更登记，按相关规定向上海证券交易所申请合并后公司股份的上市交易。

以上议案，提请各位股东审议。

方正科技集团股份有限公司董事会

2008 年 10 月 13 日

会议附件：

方正科技集团股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况报告

一、前次资金募集情况

方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2006 年度第一次临时股东大会决议通过并报经中国证券监督管理委员会批准，以公司 2005 年 12 月 31 日总股本 970,447,028 股为基数，按每 10 股配 3 股比例配售，实际配股总数为 270,816,197 股，每股配股价为人民币 2.66 元，实收配股资金人民币 720,371,084.02 元，扣除与前次配股相关的费用人民币 24,778,417.04 元，实际配股募集资金为人民币 695,592,666.98 元。上述资金于 2007 年 1 月 4 日到位，业经上海上会会计师事务所有限公司予以验证并出具上会师报字(2007)第 0012 号验资报告。

二、前次募集资金实际使用情况

截至 2008 年 6 月 30 日公司前次募集资金使用情况对照表详见附件 1。根据公司 2005 年度配股方案原计划将募集资金不超过 83,387.25 万元，全部投资于 PCB 项目，增资珠海方正科技多层电路板有限公司 61,823.25 万元，增资杭州速能方正科技有限公司 21,564.00 万元。公司实际募集资金为人民币 69,559.27 万元，对珠海方正科技多层电路板有限公司增资 48,000.00 万元，对杭州速能方正科技有限公司增资 7,368.32 万元，公司为了在中国 PCB 市场占有一席之地并发展壮大，紧跟发展趋势，高端战略地位，调整产业布局，变更了部分募集资金的投向，对重庆方正高密电子有限公司增资 14,190.95 万元，公司 2007 年度第八届董事会第五次会议和 2007 年度第一次临时股东大会决议通过变更原募集资金使用计划，并于 2007 年 11 月 19 日公布了《方正科技集团股份有限公司关于变更部分募集资金投向的公告》。

三、前次募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《公司募集资金管理制度》，于 2006 年 6 月 13 日经公司第七届董事会 2006 年第六次会议审议通过。

公司募集资金到位后，2007 年 1 月 4 日公司同保荐机构西南证券有限责任公司和两家商业银行(中国银行股份有限公司上海静安支行、上海银行普陀支行)分别签订了《募集资金三方监管协议》。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

截至 2008 年 6 月 30 日公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件 2。

珠海方正科技多层电路板有限公司新建 HDI 项目，于 2007 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，项目设计产能逐步扩大，截止 2008 年 6 月已实现净利润为 687.93 万元；

杭州方正速能科技有限公司 PCB 技改项目，由于募集资金用途改变，故原承诺的效益无法实现，2008 年 1 月至 6 月份实现净利润为 245.13 万元，2007 年同期实现净利润为-91.77 万元；

重庆方正高密电子有限公司背板和 FPC 项目尚处于建设期，未产生效益。

公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司 2007 年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、董事会意见

公司董事会认为，公司已按照配股说明书的有关承诺，确保了募集资金项目的实施，同时公司也根据实际需要有效使用了募集资金，充分发挥了募集资金的

效益。公司对前次募集资金的投向和项目进展均如实履行了披露义务。对于变更投向的部分项目，公司已根据实际情况，经股东大会批准，对部分募集资金投向实施了变更。

公司前次募集资金的投入使用，扩大了公司 PCB 的产能，全面提高了公司 PCB 业务的竞争优势，提升了公司的综合竞争实力。

方正科技集团股份有限公司董事会

2008 年 9 月 26 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 方正科技集团股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额:		69,559.27			已累计使用募集资金总额:		69,559.27			
变更用途的募集资金总额:		14,190.95			各年度使用募集资金总额:		69,559.27			
变更用途的募集资金总额比例:		20.40%			2007 年:		69,559.27			
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状	
序号	承诺投资项目	实际投资 项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金 额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承 诺投资金额的差额	态日期(或截止日项目完 工程度)
1	增资珠海方正科技多层电路 板有限公司用于新建 HDI 项 目	增资新建 HDI 项目	61,823.25	48,000.00	48,000.00	61,823.25	48,000.00	48,000.00	-	2007 年 12 月
2	增资杭州方正速能科技有限 公司用于 PCB 技改项目	增资 PCB 技改项目	21,564.00	7,216.22	7,368.32	21,564.00	7,216.22	7,368.32	152.10(汇率变动影响)	2007 年 12 月
3	增资重庆方正高密电子有限 公司投入背板和 FPC 项目	增资投入 背板和 FPC 项目	-	14,343.05	14,190.95	-	14,343.05	14,190.95	-152.10(汇率变动影响)	2009 年 4 月

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益			最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		第一年	第二年	第三年	2007	2008 中期	2009		
1	增资珠海方正科技多层电路板有限公司新建 HDI 项目	97.37%		1,609.49	7,654.47		687.93		687.93	注 1
2	增资杭州方正速能科技有限公司 PCB 技改项目	86.13%		2,715.60	3,400.46		245.13		245.13	注 2
3	增资重庆方正高密电子有限公司投入背板和 FPC 项目									

注 1: 2008 年为中期数据, 与全年数据无可比性;

注 2: 由于募集资金改变了用途, 2008 年中期实际效益与 2008 年承诺效益无可比性。

前次募集资金使用情况鉴证报告

上会师报字(2008)第 2466 号

方正科技集团股份有限公司董事会：

我们接受委托,对贵公司于 2007 年 1 月募集的人民币普通股资金(以下简称“前次募集资金”)截至 2008 年 6 月 30 日止的使用情况执行了鉴证工作。

贵公司董事会和管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制,保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断,包括对由于舞弊或错误导致的前次募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制,以设计恰当的鉴证程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制,在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2008 年 6 月 30 日止前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅供贵公司于向中国证券监督管理委员会申请配股时，作为发行申请文件的一部分向中国证券监督管理委员会报送之用，不得用作任何其他目的。

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国注册会计师

中国 上海

二〇〇八年九月二十八日

一、前次资金募集情况

方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2006 年度第一次临时股东大会决议通过并报经中国证券监督管理委员会批准,以公司 2005 年 12 月 31 日总股本 970,447,028 股为基数,按每 10 股配 3 股比例配售,实际配股总数为 270,816,197 股,每股配股价为人民币 2.66 元,实收配股资金人民币 720,371,084.02 元,扣除与前次配股相关的费用人民币 24,778,417.04 元,实际配股募集资金为人民币 695,592,666.98 元。上述资金于 2007 年 1 月 4 日到位,业经上海上会会计师事务所有限公司予以验证并出具上会师报字(2007)第 0012 号验资报告。

二、前次募集资金实际使用情况

截至 2008 年 6 月 30 日公司前次募集资金使用情况对照表详见附件 1。

根据公司 2005 年度配股方案原计划将募集资金不超过 83,387.25 万元,全部投资于 PCB 项目,增资珠海方正科技多层电路板有限公司 61,823.25 万元,增资杭州速能方正科技有限公司 21,564.00 万元。公司实际募集资金为人民币 69,559.27 万元,对珠海方正科技多层电路板有限公司增资 48,000.00 万元,对杭州速能方正科技有限公司增资 7,368.32 万元,公司为了在中国 PCB 市场占有一席之地并发展壮大,紧跟发展趋势,高端战略地位,调整产业布局,变更了部分募集资金的投向,对重庆方正高密电子有限公司增资 14,190.95 万元,公司 2007 年度第八届董事会第五次会议和 2007 年度第一次临时股东大会决议通过变更原募集资金使用计划,并于 2007 年 11 月 19 日公布了《方正科技集团股份有限公司关于变更部分募集资金投向的公告》。

三、前次募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者利益,公司根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司制定了《公司募集资金管理制度》,于 2006 年 6 月 13 日经公司第七届董事会 2006 年第六次会议审议通过。

公司募集资金到位后,2007 年 1 月 4 日公司同保荐机构西南证券有限责任公司和两家商业银行(中国银行股份有限公司上海静安支行、上海银行普陀支行)分别签订了《募集资金三方监管协议》。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

截至 2008 年 6 月 30 日公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件 2。

珠海方正科技多层电路板有限公司新建 HDI 项目,于 2007 年 12 月 31 日达到预定可使用状态,项目设计产能逐步扩大,截止 2008 年 6 月已实现净利润为 687.93 万元;

杭州方正速能科技有限公司 PCB 技改项目,由于募集资金用途改变,故原承诺的效益无法实现,

2008 年 1 月至 6 月份实现净利润为 245.13 万元，2007 年同期实现净利润为-91.77 万元；
重庆方正高密电子有限公司背板和 FPC 项目尚处于建设期，未产生效益。

公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司 2007 年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

方正科技集团股份有限公司

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

二〇〇八年九月二十六日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：方正科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		69,559.27			已累计使用募集资金总额：		69,559.27			
					各年度使用募集资金总额：		69,559.27			
变更用途的募集资金总额：		14,190.95			2007 年：		69,559.27			
变更用途的募集资金总额比例：		20.40%								
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用 状态日期(或截止日 项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投 资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投 资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投 资金额		实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额
1	增资珠海方正科技多层 电路板有限公司用于新 建 HDI 项目	增资新建 HDI 项目	61,823.25	48,000.00	48,000.00	61,823.25	48,000.00	48,000.00	-	2007 年 12 月
2	增资杭州方正速能科技有 限公司用于 PCB 技改项目	增资 PCB 技改项目	21,564.00	7,216.22	7,368.32	21,564.00	7,216.22	7,368.32	152.10(汇率变动影响)	2007 年 12 月
3	增资重庆方正高密电子有 限公司投入背板和 FPC 项目	增资投入背板 和 FPC 项目	-	14,343.05	14,190.95	-	14,343.05	14,190.95	-152.10(汇率变动影响)	2009 年 4 月

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：方正科技集团股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益			最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		第一年	第二年	第三年	2007	2008 中期	2009		
1	增资珠海方正科技多层电路板有限公司新建 HDI 项目	97.37%		1,609.49	7,654.47		687.93		687.93	注 1
2	增资杭州方正速能科技有限公司 PCB 技改项目	86.13%		2,715.60	3,400.46		245.13		245.13	注 2
3	增资重庆方正高密电子有限公司投入背板和 FPC 项目									

注 1：2008 年为中期数据，与全年数据无可比性；

注 2：由于募集资金改变了用途，2008 年中期实际效益与 2008 年承诺效益无可比性。